

檔		保存年限
號	/ /	

駐美國代表處經濟組 函

機關地址：4301 Connecticut Ave., NW
Suite 420 Washington D.C.

承辦人：蔡介文

電話：1(202)6865666

Email：cwtsai2@moea.gov.tw

受文者：經濟部

發文日期：中華民國110年9月24日

發文字號：經美字第1100001207號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文（經美1100001207_Attach1.pdf, 經美1100001207_Attach2.pdf）

主旨：有關美國商務部就「半導體供應鏈風險」徵求評論意見事，敬請查照。

說明：

- 一、本組本(110)年9月21日經美字第1100001194號函諒達。
- 二、美國商務部於本(9)月24日於聯邦公報公告，就半導體供應鏈風險(Risks in the Semiconductor Supply Chain)，徵求相關廠商於公告日後45日內提供評論意見，要點如下：

(一)相關背景：

- 1、美商務部負責拜登政府100日供應鏈檢討有關「半導體及先進封裝」部分，拜登總統本年2月24日發布有關美國供應鏈之行政命令，指示聯邦政府採取行動確保及強化美國供應鏈。白宮並於本年6月發布供應鏈報告。
- 2、半導體產品短缺正對眾多產業部門造成負面影響。為加速半導體供應鏈資訊流通，並尋找資訊落差及供應鏈瓶頸，商務部尋求利害關係人(包括國內及外國半

經濟部
國際貿易局

國際貿易局 110/09/27



1107030998

導體設計公司、半導體製造業者、原料及設備供應商、半導體中間及最終使用者)對下列問題提供回應。

(二)針對半導體產品設計、製造廠商、微電子組裝廠商、相關供應廠商及經銷商之問題：

- 1、廠商在半導體供應鏈中的角色；
- 2、可提供的晶片技術節點(technology nodes)、半導體材料類型及設備類型；
- 3、對於所生產的積體電路，請說明主要積體電路類型、產品類型、相關技術節點，以及2019年、2020年銷售額及2021年預估銷售額。
- 4、對於銷售的半導體產品，最多待配訂貨(order backlog)產品，該產品屬性(product attributes)、過去一個月銷售額、生產及封裝地區；並列出每項產品的3個最大客戶，以及每個客戶的產品銷售額占比；
- 5、生產過程各階段，廠商係內部或外部進行？對於公司銷售額最大的半導體產品，各產品2019年的前置時間(lead time)及目前前置時間，並說明目前的遲延及瓶頸情形。
- 6、廠商銷售額最大半導體產品之平均及目前庫存時間，包括成品、在製品和入庫產品(inbound product)，並說明庫存時間改變原因；
- 7、過去一年，影響公司提供產品之主要干擾及瓶頸為何？
- 8、過去3年的訂單出貨比(Book-to-Bill Ratio)？請說明改變原因。
- 9、倘若產品之需求大於產能，廠商如何分配產品供應？
- 10、是否仍有可用產能(available capacity)？若有，

部國際
騎縫章

經濟
貿易局

阻止使用該可用產能的原因為何？

- 1 1、是否考慮增加產能？若曾考慮，係以何方式，在多
久時間內，將面對什麼障礙？公司評估是否增加產
能，會考慮哪些因素？
 - 1 2、過去三年，是否改變購買原料或設備數量或作法？
 - 1 3、在未來6個月內，哪一項改變（以及供應鏈的哪一
部分）將顯著提高該廠商供應半導體產品的能力？
- (三)針對半導體產品或積體電路的中間或最終使用者之問
題：

- 1、業務類型及銷售的產品類型；
- 2、購買之半導體產品及積體電路的（一般）應用（
applications）為何；
- 3、購買最困難之半導體產品為何？購買之各產品2019年
及2021年產品屬性及購買情況，以及2021年平均每月
訂單。另，倘若生產並未面臨限制，預估公司在未來
6個月各產品之購買數量，以及實際上可購買數量。
對於公司購買最多之半導體產品，估計各產品的前置
時間，以及2019年及現在的庫存。說明目前產品遲延
或瓶頸情形。
- 4、過去一年，影響提供產品給顧客之主要干擾及瓶頸為
何？
- 5、是否因缺乏半導體而限制生產？
- 6、過去一年，有多少比例的生產必須延遲、拒絕或暫
停；
- 7、是否考慮或正在進行新投資，以減輕半導體採購的困
難；
- 8、哪些半導體產品類型最為短缺，該短缺占需求之比例
？短缺之根本原因為何；

國際
騎縫章

經濟
貿易局

- 9、過去三年，是否改變購買原料或設備數量或作法？
- 10、在未來6個月內，哪一項改變（以及供應鏈的哪一部分）將顯著提高購買半導體產品的能力；
- 11、採購訂單透過經銷商(distributors)完成以及直接向半導體產品製造廠商下訂單的比例；
- 12、對於所購買之半導體產品，購買承諾(purchase commitments)一般時間多長(幾個月)？短缺產品之購買承諾是否不同？
- 13、近幾個月，是否遭遇供應商通知無法依約定時間及數量交付產品情形？該情形是否嚴重？

三、檢送商務部公告、相關報導，併請查參。

正本：經濟部國際貿易局

副本：行政院經貿談判辦公室、經濟部、經濟部部長室、陳政務次長室(請經濟部代陳)
、經濟部工業局(均含附件)

